

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

技術詞彙表

本技術詞彙表載有本文件所用與本公司及我們的業務有關的若干技術詞彙的解釋。該等詞彙及其涵義未必與其標準行業涵義或用法一致。

「3D」	指	三維
「6G」	指	第六代蜂窩網絡技術
「12倍密電性能檢測設備」	指	針床探針點陣的排佈密度(網格密度)較單倍密度基準提升12倍的PCB電性能檢測設備，該設備主要用於HDI PCB、高精度LED板的電性能檢測，其關鍵參數包括網格間距28.98mil，單位面積探針點數1,180點/平方英寸，最小可測焊盤尺寸100μm
「AI」	指	人工智能
「AIDC」	指	AI數據中心
「AOI」	指	自動光學檢測，一種在生產過程中使用光學成像技術和圖像分析算法來檢測PCB中的缺陷和不規則性的自動檢測過程
「AVI」	指	自動視覺檢測，一種使用成像系統、照明和圖像分析軟件對PCB進行缺陷、異常或不合格視覺檢查的自動檢測過程。主要用於後期或測成品檢驗
「針床」	指	一種基於治具的電性能檢測工具，用於PCB測試，其中佈置了一組彈簧負載的接觸探針，與PCB上指定的測試點同時進行電性能接觸，以檢查其電性能
「CAD」	指	計算機輔助設計，利用軟件創建、修改、分析及優化實體物件的2D或3D數字模型，替代手工繪圖
「CAM」	指	計算機輔助製造，利用軟件及計算機控制機器完成鉗孔和元器件插裝等工序
「CCD」	指	電荷耦合器件，一種可將光信號轉換為電信號以捕捉高質量數字圖像的專用集成電路
「消費電子產品」	指	供日常家庭使用的電子設備，例如電視、行動電話及電腦。
「導通保護測試」	指	一種在受控條件下驗證電路導通性與低電阻的測試，同時通過內置的保護機制確保測試安全
「覆蓋層壓」	指	在電路上覆蓋一層保護性聚酰亞胺薄膜以實現絕緣和機械防護的工藝
「CPU」	指	中央處理器

技術詞彙表

「DER」	指	在產品開發週期中未被檢出而交付至客戶的未發現缺陷數量。
「凹坑」	指	電鍍通孔或微孔表面出現的凹陷或下陷缺陷，常見於HDI板
「DPPM」	指	每百萬零件中的缺陷數，是一種用於製造領域的質量度量指標，用於量化每生產一百萬個零件中所包含的缺陷品數量，以反映產品質量水平
「EAP」	指	設備自動化編程系統，一種用於控制生產設備實現自動化生產的系統
「EDA」	指	電子設計自動化，指一套用於在各類應用(包括集成電路及PCB)中設計、模擬、驗證、檢查及實施電子系統的軟件工具及方法論
「ERP系統」	指	企業資源規劃系統，一種集成會計、財務資料、人力資源管理及庫存管理等內外部信息以實現業務運營自動化的信息技術系統
「靜電防護」	指	靜電放電保護，指在PCB測試過程中用於防止靜電突然爆發損壞敏感電子元件的程序、設備和設計特點
「蝕刻」	指	一種將基板上多餘銅箔去除，僅保留所需導電軌道或線路以形成電路的製造工序
「激勵」	指	為測量目的，對電路或元件施加受控訊號(通常為電流)的過程
「治具」	指	一種用於自動化PCB質量檢測的專用工具，通過探針等接觸部件建立可靠電連接，以實現對PCB的各類測試
「四線測試」	指	一種採用兩對獨立探針分別進行電流注入與電壓測量的測試方法。通過消除探針及接觸電阻的影響，可實現高精度測量，適用於高精度測試場景
「FPC」	指	柔性印刷電路，一種超薄、輕質的PCB，由柔性絕緣基板製成，可彎折以適配所裝配設備的外形；通常用於移動部件，如相機鉸鏈、筆記本電腦屏幕和汽車傳感器
「FQC」	指	最終質量控制
「G」	指	千兆比特，一種數據計量單位，等於十億比特
「GDP」	指	國內生產總值，在特定時間內一國境內所生產的所有最終商品與服務的貨幣價值總額。
「Gerber RS-274X」	指	PCB製造中使用的標準可讀檔案格式，用於描述二維影像數據

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

技術詞彙表

「GFA」	指	總建築面積
「HDI」	指	高密度互連技術，一種可讓PCB設計師在極小空間內實現大量線路互連的先進製造工藝
「HLC」	指	高層數
「高端PCB」	指	具備高層數、高密度互連、高精度及高附加價值的PCB，包括18層及以上層數的PCB、HDI PCB以及IC載板
「IC」	指	集成電路，一種半導體器件，它將多個電子元件和電路功能集成到單個芯片上，以執行特定的處理、控制、存儲或與信號有關的功能
「在線檢測速度」	指	自動化系統對生產線中流轉的電路板進行檢測的速度與效率
「絕緣測試」	指	一種用於評估PCB導電特徵之間絕緣性能的測試方法
「低阻測試」	指	測量極低電阻值以檢測電子元件內故障的過程
「IO」	指	輸入／輸出
「ISO」	指	國際標準化組織，一個獨立的國際機構，負責制定和發佈標準，以確保各個行業和國家的質量、安全、效率和一致性
「開爾文測量法」	指	一種四線式電性能測量配置，可高精度測定被測器件的精確電阻值
「漏電測試」	指	一種在受控電壓下測量漏電流以計算導體間絕緣電阻的電性能檢測
「LED」	指	發光二極管，一種通電時利用半導體發光的電子元器件
「LEO」	指	低地球軌道
「低空經濟」	指	在1,000米以下空域進行的經濟活動，涵蓋廣泛的應用場景，包括救援、勘察及客貨運輸。
「MES」	指	製造執行系統，一種用於監控、追蹤及管控車間生產作業的信息系統
「MicroLED」	指	一種採用微米級無機發光二極管作為單個像素或子像素的自發光顯示技術，可提供高亮度、高對比度、快速響應時間和高可靠性。它依賴於高精度PCB背板作為其電性能基礎，其中微小芯片直接連接到PCB上以管理電源和熱量
「mil」	指	一種等於千分之一英吋的長度單位

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

技術詞彙表

「MOQ」	指 最小訂購量
「MPQ」	指 最小包裝量
「mΩ」	指 毫歐，一種電阻單位，常用於測量極低阻值
「MΩ」	指 兆歐，電阻單位，常用於量測極高電阻值。
「ODB++」	指 用於PCB設計至製造流程中的數據交換格式，以傳輸完整的製造、組裝及測試數據
「開路」	指 電路路徑中斷或斷開，導致電流無法流通的電路狀態。
「焊盤」	指 電路板上用於焊接電子元器件的銅質區域
「PCB」	指 印刷電路板，一種扁平的絕緣板，通過蝕刻或印刷形成的導電線路、焊盤和走線實現電子元器件機械支撐與電性能連接，為大多數電子設備的基礎部件
「QA」	指 品質保證
「Q Mes」	指 車間質量執行系統，專注於生產過程質量控制、生產監控與可追溯性管理
「研發」	指 研究及開發
「短路」	指 電路中電流沿非預期路徑流動，且該路徑電氣阻抗極低或為零，導致流經電路的電流過大的電路狀態。
「SLP」	指 類似PCB的基板，銜接傳統HDI PCB與IC載板的超高密度電路板
「阻焊層」	指 一種薄如清漆的聚合物塗層，塗覆PCB的銅質線路上，用於保護電路板免受環境侵蝕，並在組裝或使用過程中防止意外短路
「阻焊檢測」	指 在元件焊接前，對PCB上的阻焊層進行檢查，以確保其塗覆正確、位置準確且不存在缺陷的過程
「火花測試」	指 一種通過施加高電壓和識別絕緣薄弱點的放電現象，從而檢測PCB中潛在的絕緣缺陷的高壓絕緣測試
「SPC」	指 統計過程控制，運用統計方法監控與控制生產過程質量
「平方米」	指 平方米，一種面積單位
「基板」	指 為PCB的電路提供機械支持及電性能絕緣的基礎非導電材料。銅箔被覆蓋於基板之上，隨後經過圖案化形成導線及焊盤，電子元件被安裝於基板之上
「T」	指 太比特，一種數位資訊單位，等於一萬億比特。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

技術詞彙表

「二線測試」	指 一種採用同一對探針同時進行電流注入與電壓測量的測試方法。由於測量結果包含探針及接觸電阻的影響，通常適用於精度要求相對較低的應用場景
「微短路」	指 一種比全短路更加難以檢測的高電阻且間斷性的PCB短路
「微短路測試」	指 一種用於檢測常規短路測試難以發現的細微潛在短路的檢測方法
「 μm 」	指 微米，一種等於一百萬分之一米的長度單位
「 $\mu\text{m}/\text{pixel}$ 」	指 每像素微米，一種用於衡量成像系統物理空間分辨率的指標，表示單個像素所對應的實際物理距離
「設備層面對准測試」	指 對PCB的關鍵區域進行局部定位，以確保在電性能檢測期間準確對齊並可靠計量的測試
「糾偏系統」	指 一種製造業中用於在加工前對卷材等平面材料進行定位的自動閉環控制機制